

2013年11月28日
パナソニック株式会社

回路基板事業の縮小について

パナソニック株式会社は、経営環境の変化に対応し、オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社（以下、AIS社）の回路基板事業について、事業構造転換を含む様々な方策を検討してきましたが、事業の継続が困難であるとの判断の下、樹脂多層基板（以下、ALIVH^{※1}）事業および三洋電機株式会社が行う薄型・高密度配線板（以下、ISB^{※2}）事業を終息し、回路基板事業を縮小します。

具体的には、国内では三重県松阪市（ALIVH事業）および群馬県邑楽郡大泉町（ISB事業）の各拠点において、2013年度末から2014年度中を目処に順次生産終了します。

事業終息する部門の国内従業員につきましては、AIS社内を中心にパナソニックグループ内での異動・再配置を基本とし、従業員の意思を尊重しながら雇用確保を前提に労使で協議を進めていきます。

当社の回路基板事業は、1960年の片面プリント配線板の生産に始まり、1996年にALIVH事業を開始しました。また、2012年からは三洋電機のISB事業との一体運営も展開してきました。今回のALIVH事業、ISB事業の終息により、回路基板事業は大幅に縮小しますが、AIS社はパナソニックグループにおけるBtoBビジネスの牽引役として、車載・産業・ICT分野を軸にお客様のご要望を満たす、より魅力ある製品開発とその提供に努め、今後もグローバルに事業展開していきます。

なお、ベトナム、台湾の海外2拠点のこれら事業についても、今回の改革の中で2014年度中に生産を終了する予定です。

本件による連結業績影響については、現在精査中ではありますが、当社の2014年3月期連結業績予想への重要な影響はない見込みです。

※1. ALIVH: Any Layer Interstitial Via Hole。当社が開発・事業化した全層IVH (Interstitial Via Hole)構造の樹脂多層基板。

※2. ISB: Integrated System in Board。三洋電機が開発・事業化したファインパターン形成による主に半導体パッケージ向けの薄型・高密度配線板。

以上

(ご参考)

<ALIVH および ISB の生産を終了する拠点>

※各拠点ではALIVHおよびISB以外の事業も営んでおり、拠点閉鎖はありません。

【松阪拠点】

拠点名 : パナソニック株式会社
オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 松阪工場
所在地 : 三重県松阪市上川町2460番地1号
操業開始 : 1970年4月 (ALIVH:1997年10月)
事業内容 : 機構部品、回路基板(ALIVH)の開発・製造・販売

【群馬拠点】

拠点名 : 三洋電機株式会社 東京製作所
所在地 : 群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号
操業開始 : 1959年7月 (ISB:2005年12月)
事業内容 : 業務用冷凍庫、ショーケース、大型空調、回路基板(ISB)等の
開発・製造・販売

【ベトナム拠点】

拠点名 : パナソニック デバイス ベトナム有限会社
所在地 : ハノイ市
操業開始 : 2006年4月 (ALIVH:2012年10月)
事業内容 : 機構部品、回路基板(ALIVH、ISB)の製造・販売

【台湾拠点】

拠点名 : パナソニック台湾株式会社
所在地 : 新北市
操業開始 : 1962年10月 (ALIVH:2005年4月)
事業内容 : アプライアンス事業、AVC事業、カーエレ事業、部品事業の
開発・製造・販売